



上海新阳半导体材料股份有限公司

2014 年第一季度报告

二〇一四年四月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王福祥、主管会计工作负责人邵建民及会计机构负责人(会计主管人员)周红晓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	55,000,328.97	30,331,185.45	81.33%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	8,719,475.19	7,065,687.05	23.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,825,469.89	4,592,776.42	-60.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.016	0.0539	-70.32%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.09%	1.86%	-0.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.06%	1.85%	-0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	915,542,359.27	951,994,824.33	-3.83%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	805,232,238.50	795,467,091.50	1.23%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.0759	6.99	1.23%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	18,450.00	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	135,531.06	02 专项专项补助 12.40 万元,其他政府补助 1.15 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	199,153.44	购买银行理财产品所得投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,344.00	捐赠支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-104,071.28	与专项当期确认政府补助收入所对应的费用支出。
减：所得税影响额	-28,907.88	
合计	221,627.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、新产品开发所面临的风险

公司的电子化学品具有品种多、批量少、升级快、研发投入大、周期长、风险高等特点，需要持续开发和创新。产品研发试制成功后，进行大规模生产时，任何设备工艺参数缺陷、员工素质差异等都可能导导致产品品质波动，面临产品难以规模化生产风险。

公司通过多年持续不断的研发投入，加强技术储备和科研管理，掌握了自主知识产权的核心技术，在电子化学品研发及生产领域积累了较为丰富的经验和技術储备，能够降低新产品开发的风险。

2、新产品市场推广风险

由于芯片制造工艺对环境、材料的严格要求，芯片制造企业一般选择认证合格的安全供应商保持长期合作，从而降低材料供应商变化可能导致的产品质量风险；同时，新的材料供应商必须通过芯片制造企业严格的公司和产品评估认证才能成为其合格供应商。因此，公司芯片铜互连电镀液及添加剂等新产品大规模市场销售市场推广面临客户的认证意愿、对公司质量管理能力的认可以及严格的产品认证等不确定因素，存在一定的市场推广风险。

公司一直高度重视新市场推广工作，并通过加大新产品市场开发投入、严格新产品质量管理、引进新市场专业人员等手段控制新市场推广的风险。

3、投资规模扩张和研发投入导致盈利能力下降的风险

随着募投项目逐步建成投产，公司投资规模迅速扩大，固定资产大幅增加将导致折旧成本大幅增加，同时公司近年来研发投入较大，如果公司市场开发工作进展不顺利，营业收入不能实现同步增长，将会导致公司盈利能力下降的风险。公司将全力做好新市场开发，不断挖掘和发现新的客户，力争减少盈利能力下降的风险。同时公司也集约运行，从管理上挖掘潜力，把运行成本的上升控制到最小程度。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	3,393					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE	境外法人	22.38%	25,472,000	25,472,000		

LTD						
上海新晖资产管理 有限公司	境内非国有法人	19.59%	22,288,000	22,288,000		
上海新科投资有 限公司	境内非国有法人	13.99%	15,920,000	15,920,000		
李昊	境内自然人	10.75%	12,233,938	12,233,938		
苏州和信达股权 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	3.04%	3,460,104	3,460,104		
周海燕	境内自然人	2.69%	3,058,484	3,058,484		
王霞	境内自然人	2.17%	2,471,503	2,471,503	质押	2,471,500
耿雷	境内自然人	1.79%	2,038,990	2,038,990		
胡美珍	境内自然人	1.63%	1,853,627	1,853,627	质押	1,850,000
中国工商银行一 申万菱信新经济 混合型证券投资 基金	其他	1.02%	1,166,445	1,166,445		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
# 杨旭明	1,374,700	人民币普通股	1,374,700			
中国工商银行一申万菱信新经济 混合型证券投资基金	1,166,445	人民币普通股	1,166,445			
中国建设银行一华夏红利混合型 开放式证券投资基金	1,006,868	人民币普通股	1,006,868			
中国平安财产保险股份有限公司 一传统一普通保险产品	980,639	人民币普通股	980,639			
温美华	427,800	人民币普通股	427,800			
赵洪林	355,396	人民币普通股	355,396			
陈占宵	337,000	人民币普通股	337,000			
陶市洲	330,000	人民币普通股	330,000			
秦伟仪	322,978	人民币普通股	322,978			
中国工商银行一申万菱信消费增 长股票型证券投资基金	299,833	人民币普通股	299,833			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	发起人股东 SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司为关联公司，属同一控制人控制下的一致行动人。李昊、苏州和信达股权投资合伙企业（有限合伙）、周海燕、王霞、耿雷、胡美珍是本次重大资产重组后持有公司有限售条件流通股 14 名股东的其中 6 名，其中李昊与周海燕为夫妻					

	关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。
--	------------------------------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	25,472,000	0	0	25,472,000	发起人股份	2014-06-29
上海新晖资产管理有限公司	22,288,000	0	0	22,288,000	发起人股份	2014-06-29
上海新科投资有限公司	15,920,000	0	0	15,920,000	发起人股份	2014-06-29
李昊	12,233,938	0	0	12,233,938	协议约定	2016-10-17
周海燕	3,058,484	0	0	3,058,484	协议约定	2016-10-17
耿雷	2,038,990	0	0	2,038,990	协议约定	2016-10-17
孙国平	815,596	0	0	815,596	协议约定	2016-10-17
周明峰	407,798	0	0	407,798	协议约定	2016-10-17
陶月明	407,798	0	0	407,798	协议约定	2016-10-17
王海军	305,848	0	0	305,848	协议约定	2016-10-17
徐辉	305,848	0	0	305,848	协议约定	2016-10-17
程焱	407,798	0	0	407,798	协议约定	2014-10-17
罗瑞娥	407,798	0	0	407,798	协议约定	2014-10-17
胡美珍	1,853,627	0	0	1,853,627	协议约定	2014-10-17
王霞	2,471,503	0	0	2,471,503	协议约定	2014-10-17
苏州和信达股权投资合伙企业（有限合伙）	3,460,104	0	0	3,460,104	协议约定	2014-10-17
苏州国发黎曼创业投资有限公司	444,870	0	0	444,870	协议约定	2014-10-17
合计	92,300,000	0	0	92,300,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

1、应收利息：报告期末，应收利息比上年期末减少110.33万元，下降75.09%。

(1) 报告期末，母公司比上年期末减少87.74万元，下降71.03%，主要原因是上年银行定存资金本报告期内实现利息收入所致；

2、存货：报告期末，存货比上年期末增加2053.71万元，增长44.22%。

(1) 报告期末，母公司比上年期末增加1231.17万元，增长68.26%，主要原因是本报告期设备在制品未完工和设备未交付，增加存货1093万元所致；

(2) 报告期末，考普乐存货余额3662.91万元，本报告期存货比上年期末增加822.54万元，增长28.96%；

3、其他流动资产：报告期末，其他流动资产比上年期末减少68.00万元，下降99.97%。

(1) 报告期末，母公司其他流动资产比上年期末减少59.98万元，下降100%，主要原因是上年末转入其他流动资产的未交增值税在本报告期缴纳所致；

(2) 报告期末，考普乐其他流动资产余额7.45万元，本报告期其他流动资产比上年期末没有变动。

4、持有至到期投资：报告期末，持有至到期投资比上年期末增加1370万元，增长91.33%。

(1) 报告期末，母公司持有至到期投资比上年期末增加400万元，增长36.36%，主要原因是购买银行理财产品所致；

(2) 报告期末，考普乐持有至到期投资比上年期末增加970万元，增长100%，主要原因是购买银行理财产品所致；

5、应付票据：报告期末，应付票据比上年期末减少3508.97万元，下降73.41%。

(1) 报告期末，母公司应付票据比上年期末减少12.21万元，下降23.46%；

(2) 报告期末，考普乐应付票据比上年期末减少3496.76万元，下降73.96%，主要原因是本报告期支付到期应付票据所致；

6、应付职工薪酬：报告期末，应付职工薪酬比上年期末减少216.79万元，下降69.78%。

(1) 报告期末，母公司应付职工薪酬比上年期末减少158.38万元，下降62.78%；主要原因是本报告期发放2013年度计提的奖金；

(2) 报告期末，考普乐应付职工薪酬比上年期末减少58.41万元，下降100%，主要原因是本报告期发放2013年度计提的奖金；

7、应交税费：报告期末，应交税费比上年期末减少343.18万元，下降35.60%。

(1) 报告期末，母公司应交税费比上年期末增加65.45万元，增长60.42%，主要原因是本报告期末计提应交各项税费增加所致；

(2) 报告期末，考普乐应交税费比上年期末减少408.74万元，下降47.76%，主要原因是本报告期缴纳计提税金所致；

8、应付利息：报告期末，应付利息比上年期末增加0.78万元，增加33.33%。主要原因是考普乐计提应付利息所致；

(二) 利润表项目

1、营业收入：本报告期营业收入比上年同期增加2466.91万元，增长81.33%。

(1) 本报告期母公司比上年同期减少427.10万元，下降14.08%；

(2) 合并考普乐后，本报告期营业收入增加2894.01万元；

- 2、营业成本：本报告期营业成本比上年同期增加1599.45万元，增长107.00%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期减少78.10万元，下降5.22%；
- (2) 合并考普乐后，本报告营业成本增加1677.55万元；
- 3、营业税金及附加：本报告期营业税金及附加比上年同期增加8.41万元，增长83.23%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期减少6.93万元，下降68.56%，主要原因是本报告期应纳增值税减少所致。
- (2) 合并考普乐后，营业税金及附加增加15.34万元；
- 4、销售费用：本报告期销售费用比上年同期增加266.91万元，增长191.90%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期增加40.16万元，增加28.87%；
- (2) 合并考普乐后，销售费用增加226.75万元；
- 5、管理费用：本报告期管理费用比上年同期增加284.71万元，增长32.24%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期减少45.83万元，下降5.19%；
- (2) 合并考普乐后，管理费用增加324.99万元；
- 6、财务费用：本报告期财务费用比上年同期增加45.51万元，增长31.40%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期增加22.98万元，增长16.65%；
- (2) 合并考普乐后，财务费用增加15.55万元；
- 7、资产减值损失：本报告期资产减值损失比上年同期减少79.19万元，下降413.05%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期减少5.48万元，下降29.63%；
- (2) 合并考普乐后，资产减值损失减少74.40万元；
- 8、营业外收入：本报告期营业外收入比上年同期减少150.80万元，下降90.73%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期减少151.90万元，下降91.40%，主要原因是：本报告期政府补助收入减少所致；
- (2) 合并考普乐后，营业外收入1.10万元。
- 9、营业外支出：本报告期营业外支出比上年同期增加4.67万元，增长485.25%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期增加2.67万元，增长277.51%，主要原因是本报告期捐赠支出增加所致；
- (2) 合并考普乐后，营业外支出增加2万元。
- 10、所得税费用：本报告期所得税费用比上年同期增加45.57万元，增长35.37%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期减少78.18万元，下降60.68%，主要原因是本报告期利润总额减少所致；
- (2) 合并考普乐后，所得税费用增加123.75万元。
- 11、利润总额和净利润：本报告期母公司利润总额比上年同期下降488.54万元，下降59.12%；净利润下降410.36万元，下降58.83%。主要原因为：本报告期母公司销售收入比上年同期减少，自主研发费用投入增加，人力资源成本上升，募投项目运行成本上升。

(三) 现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加3187.20万元，增长75.78%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期减少659.04万元，下降15.67%；
- (2) 合并考普乐后，销售商品、提供劳务收到的现金增加3846.24万元；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金：本报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加96.30万元，增长1643.71%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期增加70.08万元，增长1382.56%，主要原因是本报告期收回员工借款及往来款所致；
- (2) 合并考普乐后，收到其他与经营活动有关的现金增加20.88万元；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加2857.33万元，增长137.86%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期增加358.32万元，增长17.29%，

- (2) 合并考普乐后, 购买商品、接受劳务支付的现金增加2499.01万元
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金: 本报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加558.04万元, 增长90.65%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期增加155.64万元, 增长25.28%;
- (2) 合并考普乐后, 支付给职工以及为职工支付的现金增加397.45万元;
- 5、收回投资收到的现金: 本报告期收回投资收到的现金比上年同期增加4200.95万元, 增长100%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期增加3500万元, 增长100%, 主要原因是收回购买银行理财产品本金所致;
- (2) 合并考普乐后, 收回投资收到的现金增加300.95万元;
- 6、取得投资收益所收到的现金: 本报告期取得投资收益所收到的现金比上年同期增加25.30万元, 增长100%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期增加19.92万元, 增长100%, 主要原因是收到银行理财产品投资收益所致;
- 7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额: 本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加2.30万元, 增长100%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期增加2.30万元, 增长100%, 主要原因是本报告期取得处置固定资产收益所致;
- 8、收到其他与投资活动有关的现金: 本报告期收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加61.89万元, 增长43.08%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期增加68.83万元, 增长50.35%, 主要原因是本报告期利息收入增加所致;
- 9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金: 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加697.30万元, 增长59.63%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期减少76.05万元, 下降6.50%;
- (2) 合并考普乐后, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加773.35万元;
- 10、投资支付的现金: 本报告期投资支付的现金比上年同期增加5570万元, 增长100%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期增加4212.86万元, 增长100%, 主要原因是本报告期购买银行理财产品支付本金及支付上海新阳海斯投资款所致;
- (2) 合并考普乐后, 投资支付的资金增加1270万元。
- 11、支付其他与筹资活动有关的现金: 本报告期支付其他与筹资活动有关的现金减少364.32万元, 下降88.15%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期减少364.32万元, 下降88.15%, 主要原因是本报告期02项目的结束支出减少所致。
- 12、汇率变动对现金及现金等价物的影响: 本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响减少2.43万元, 下降93.03%。
- (1) 本报告期母公司比上年同期减少2.45万元, 下降93.53%, 主要原因是本报告期汇率变动所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内, 公司实现营业收入5500.03万元, 比去年同期增长81.33%, 实现归属于上市公司股东的净利润871.95万元, 比去年同期增长23.41%。营业收入和利润的增长主要是由于公司合并考普乐后实现了一定的业绩增长。母公司由于营业收入未能实现同步增长, 致使经营业绩受到一定影响。

2014年第一季度, 公司紧紧围绕着年初制定的经营计划开展工作。

市场开发、新产品推广和验证工作取得了一定进展。例如: 芯片铜互连电镀液产品在中芯国际(上海)采购份额有所增加, 在无锡海力士半导体(中国)有限公司产品已经通过技术验证, 并且顺利通

过了海力士对公司的现场稽核, 双方进入合作协议的签订环节; 芯片铜互连清洗液通过了中芯国际(上海)部分产能的验证并获得了少量订单; 除了面向国内半导体客户外, 公司也投入力量在台湾、东南亚等地积极拓展市场。这些为公司未来在半导体高端制程材料市场中立足和发展打下了良好的基础。

另外, 经过前期准备公司组建了半导体划片项目团队, 从事半导体划片化学品和划片刀配套应用, 有望在2014年度实现销售, 进一步提高公司产品在半导体市场的销售规模。同时, 公司组建了基板项目团队, 将公司电镀和清洗技术应用于半导体IC基板领域。

报告期内, 公司募投项目进入最后的试生产调试阶段, 预计今年第二季度达到预定可使用状态。募投项目新产能的建成将为公司长远发展打下良好基础。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

随着公司募投项目和02专项完成投资与建设, 随着公司正式进入半导体前道制程领域, 随着公司并购重组与投资合作的完成, 2014年, 上海新阳发展到了一个完全不同以往的新阶段。公司的资源投入规模已经可以满足一个较大公司的运营要求, 公司在研发和生产方面所具备的条件足够支撑较大规模的业绩产出。因此, 如何将公司的资源投入尽快转化为经营业绩产出, 是我们2014年所面临的最主要课题。为此, 考虑按照“紧抓三条主线、做好七个方面具体工作”的思路来展开公司2014年的各项工作。三条主线分别为:

- 一、提升经营业绩, 实现销售收入突破
- 二、做好产品研发, 开展科研项目管理
- 三、加强质量控制, 确保产品质量稳定

同时, 2014年需要做好以下七个方面具体工作: 一、做好募投项目结尾工作和十二五02专项验收工作; 二、做好上市公司规范运作和子公司管理工作; 三、做好人力资源管理和队伍建设工作; 四、做好预算管

理和成本优化工作；五、推进知识产权工作，提高技术管理水平；六、做好流程和体系文件优化工作；七、做好安全环保工作，完成EHS工作目标。

2014年第一季度，公司紧紧围绕着年初制定的经营计划开展工作。

市场开发、新产品推广和验证工作取得了一定进展。例如：芯片铜互连电镀液产品在中芯国际（上海）采购份额有所增加，在无锡海力士半导体（中国）有限公司产品已经通过技术验证，并且顺利通过了海力士对公司的现场稽核，双方进入合作协议的签订环节；芯片铜互连清洗液通过了中芯国际（上海）部分产能的验证并获得了少量订单；除了面向国内半导体客户外，公司也投入力量在台湾、东南亚等地积极拓展市场。这些为公司未来在半导体高端制程材料市场中立足和发展打下了良好的基础。

另外，经过前期准备公司组建了半导体划片项目团队，从事半导体划片化学品和划片刀配套应用，有望在2014年度实现销售，进一步提高公司产品在半导体市场的销售规模。同时，公司组建了基板项目团队，将公司电镀和清洗技术应用于半导体IC基板领域。

报告期内，公司募投项目进入最后的试生产调试阶段，预计今年第二季度达到预定可使用状态。募投项目新产能的建成将为公司长远发展打下良好基础。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、新产品开发所面临的风险

公司的电子化学品具有品种多、批量少、升级快、研发投入大、周期长、风险高等特点，需要持续开发和创新。产品研发试制成功后，进行大规模生产时，任何设备工艺参数缺陷、员工素质差异等都可能导导致产品品质波动，面临产品难以规模化生产风险。

公司通过多年持续不断的研发投入，加强技术储备和科研管理，掌握了自主知识产权的核心技术，在电子化学品研发及生产领域积累了较为丰富的经验和技術储备，能够降低新产品开发的风险。

2、新产品市场推广风险

由于芯片制造工艺对环境、材料的严格要求，芯片制造企业一般选择认证合格的安全供应商保持长期合作，从而降低材料供应商变化可能导致的产品质量风险；同时，新的材料供应商必须通过芯片制造企业严格的公司和产品评估认证才能成为其合格供应商。因此，公司芯片铜互连电镀液及添加剂等新产品大规模市场销售市场推广面临客户的认证意愿、对公司质量管理能力的认可以及严格的产品认证等不确定因素，存在一定的市场推广风险。

公司一直高度重视新市场推广工作，并通过加大新产品市场开发投入、严格新产品质量管理、引进新市场专业人员等手段控制新市场推广的风险。

3、行业和市场波动风险

半导体产业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点。公司主营业务处于半导体产业链的材料和设备支撑行业，其市场需求和全球及国内半导体产业的发展状况息息相关，因此，本公司的业务发展会受到半导体行业周期性波动的影响。如果全球及国内半导体行业再度进入发展低谷，则公司将面临业务

发展放缓、业绩产生波动的风险。

未来几年公司将在技术开发和市场开发加大投入。开发市场、加速进口替代可以扩大公司市场份额，保证经营业绩；开发技术、持续推出新产品可以不断拓宽公司产品应用领域，提高产品毛利。

4、安全环保风险

公司从产品生产工艺看属精细化工行业，虽然公司细分产品多为配方类的电子化学品，生产过程的污染工艺较少，但在生产经营中仍存在着少量“三废”排放。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求提高，环保治理成本将不断增加。同时，本公司生产过程中使用的部分原材料为酸碱和有机溶剂，如操作不当可能发生安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。

公司对安全和环保工作高度重视，通过了环境管理体系、职业健康与安全管理体系、安全标准化企业等多项认证，并获得了安全生产许可证、危险化学品经营许可证等资质，能够有效减少安全环保方面的风险。

5、核心技术泄密风险

公司拥有多项国家发明专利和实用新型专利，在不断研发的过程中，公司还形成了较多的非专利技术和核心配方，这些技术和配方都是公司技术领先的保证。如果出现任何侵犯本公司专利或相关知情人士违反保密义务的情形，可能对公司的正常经营产生不利影响。

公司自成立以来就非常注重对专利、非专利技术和核心配方的保护，为了保证公司的核心机密不外泄，公司与董事、监事、高级管理人员、所有研发人员以及管理、财务等各个岗位的核心人员均签订了《保密协议书》，采取了配方保密、专人保管等特殊方法，并通过岗位分离及权限设置，避免部分技术人员掌握全部核心技术内容，最大限度的降低核心技术泄密风险。

6、投资规模扩张和研发投入导致盈利能力下降的风险

随着募投项目逐步建成投产，公司投资规模迅速扩大，固定资产大幅增加将导致折旧成本大幅增加，同时公司近年来研发投入较大，如果公司市场开发工作进展不顺利，将会导致公司盈利能力下降的风险。公司将全力做好新市场开发，不断挖掘和发现新的客户，力争减少盈利能力下降的风险。同时公司也集约运行，从管理上挖掘潜力，把运行成本的上升控制到最小程度。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司关于股权激励的承诺事项	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2011年11月07日	2011年11月7日至2015年12月31日	报告期内公司严格履行了上述承诺
资产重组时所作承诺	李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	上海新阳本次向李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉等八名股东发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2013年04月25日	2013年10月18日至2016年10月17日	截至本报告出具日,该承诺仍在履行过程中,承诺人无违反该承诺的情况
	程焱、罗瑞娥、胡美珍、王霞、苏州和信达及国发黎曼	上海新阳向程焱、罗瑞娥、胡美珍、王霞、苏州和信达及国发黎曼等六名股东发行的股份自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。	2013年04月25日	2013年10月18日至2014年10月17日	截至本报告出具日,该承诺仍在履行过程中,承诺人无违反该承诺的情况
	李昊等考普乐 14 名股东	考普乐 2013 年、2014 年、2015 年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 3,620 万元、4,055 万元、4,580 万元。如考普乐在承诺期内未能实现承诺净利润,则交易对方需向上市公司进行补偿。	2013年04月25日	2013年1月1日至2015年12月31日	考普乐 2013 年实现的合并报表扣非后净利润为 3797.56 万元,完成了 2013 年业绩承诺。截至本报告出具日,该承诺仍在履行过程中,承诺人无违反该承诺的情况。
	李昊	如罗瑞娥等五名现金补偿义务人及程焱不能履行《发行股份购买资产盈利补偿协议》约定的现金补偿义务,则本人承担连带责任,向上海新阳半导体材料股份有限公司承担相应的现金补偿义务。	2013年04月25日	2013年1月1日至2015年12月31日	截至本报告出具日,该承诺仍在履行过程中,承诺人无违反该承诺的情况。
	李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	为保证标的公司持续稳定地开展生产经营,李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉等七名管理层股东承诺自资产交割日起,仍需至少在标	2013年04月25日	2013年9月26日至2018年9月25日	截至本报告出具日,该承诺仍在履行过程中,承诺人无违反

		的公司任职 60 个月，并与标的公司签订期限为 60 个月的《劳动合同》，且在标的公司不违反相关劳动法律法规的前提下，不得单方解除与标的公司的劳动合同。如任何一名管理层股东违反任职期限承诺，则该违约方应向上海新阳进行补偿。			该承诺的情况。
	李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	本次交易完成后，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与上海新阳及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与上海新阳及其下属公司经营的业务构成或可能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企业现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与上海新阳及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入上海新阳的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与上海新阳主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。	2013 年 04 月 25 日	长期	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
	李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉、程焱	本人在股份限售期内不转让所持股份，对取得的上海新阳股份不设置质押等权利受限的其他行为，不从事不能清偿到期债务从而导致本人所持股份被冻结和强制执行的经济行为等，以保证本人切实履行与上海新阳之间《发行股份购买资产盈利预测补偿协议》中的股份补偿义务。	2013 年 04 月 25 日	2013 年 10 月 18 日至 2016 年 10 月 17 日	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	三名法人股东关于股份锁定的承诺	自上海新阳半导体材料股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前本公司已持有的上海新阳半导体材料股份有限公司股份，也不由上海新阳半导体材料股份有限公司回购在本次发行前本公司已持有的上海新阳半导体材料股份有限公司股份。	2011 年 06 月 16 日	2011 年 6 月 29 日至 2014 年 6 月 28 日	报告期内各股东均严格履行了上述承诺。
	董事、监事、高级管理人员王福祥、孙江燕、陈佩卿、	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不	2011 年 06 月 16 日	2011 年 6 月 29 日至 2014 年 6 月 28 日	报告期内各承诺人均严格履行了上述承诺。

	贺岩峰、吕海波、智文艳、王振荣、徐玉明关于股份锁定的承诺	由公司回购其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份。在上述承诺期满后，在其或其关联自然人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的百分之二十五；在其或其关联自然人离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。			
	本公司间接股东王福祥、孙江燕、陈佩卿、贺岩峰、吕海波、智文艳、王振荣、陈慧、张驰、陈宏霞、徐玉明关于股份锁定的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的新加坡新阳/新晖管理/新科投资的股权，也不由新加坡新阳/新晖管理/新科投资回购本人持有的股权；同时，承诺在上述期间，所持新加坡新阳/新晖管理/新科投资的股权比例不发生变动。	2011年06月16日	2011年6月29日至2014年6月28日	报告期内各承诺人均严格履行了上述承诺。
	本公司间接股东王溯（系实际控制人、董事王福祥和孙江燕之子）关于股份锁定的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托王福祥以外的其他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本次发行前其直接或间接持有的公司股份。上述承诺期满后，在其或其关联自然人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的百分之二十五；在其或其关联自然人离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份。自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托王福祥以外的其他人管理其持有的新晖管理的股权，也不由新晖管理回购其持有的股权；同时，承诺在上述期间，所持新晖管理的股权比例不发生变动。	2011年06月16日	2011年6月29日至2014年6月28日	报告期内各承诺人均严格履行了上述承诺。
	实际控制人王福祥、孙江燕夫妇的其他承诺	如股份公司及上海新阳电子化学有限公司因股份公司首次公开发行股票并在创业板上市前违反国家和地方外资管理、税收、社会保险及住房公积金等相关法律法规而被处罚的情形，则相关费用由本人全额承担。	2010年07月30日	长期	报告期内承诺人严格履行了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	三名法人股东关于避免同业竞争的承诺	本公司目前未从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似的业务，也未投资与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似业务的其他企业，不存在与上海新阳半导体材料股份有限公	2010年07月30日	长期	报告期内各股东均严格履行了上述承诺。

		司及其控股子公司直接或间接同业竞争的情况。本公司将来也不直接或间接从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务；如从第三方获得的任何与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会，则立即通知上海新阳半导体材料股份有限公司，并尽力将该商业机会让予上海新阳半导体材料股份有限公司。			
	实际控制人王福祥、孙江燕夫妇关于避免同业竞争的承诺	本人及本人直系亲属目前未从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似的业务，也未投资与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似业务的其他企业，不存在与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司直接或间接同业竞争的情况。本人及本人直系亲属将来也不直接或间接从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务；如从第三方获得的任何与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会，则立即通知上海新阳半导体材料股份有限公司，并尽力将该商业机会让予上海新阳半导体材料股份有限公司。	2010年07月30日	长期	报告期内承诺人严格履行了上述承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。注：承诺方李昊等 14 名原考普乐股东目前只有李昊持有本公司 5%以上股份，其余 13 名股东持有本公司股份未达 5%。（此句话加在表的最后）				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	21,452.52	本季度投入募集资金总额	1,394.78
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	10,863.66
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
半导体封装化学材料技术改造项目	否	11,201.03	11,201.03	-109.47	6,874.18	61.37%	2014年06月30日	0	0	否	否
半导体封装表面处理设备技术改造项目	否	3,311.39	3,311.39	397.12	1,587.7	47.95%	2014年06月30日	0	0	否	否
技术中心改造项目	否	2,987.57	2,987.57	790.13	1,294.77	43.34%	2014年06月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	17,499.99	17,499.99	1,077.78	9,756.65	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
补充流动资金(如有)	--			317	1,107		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			317	1,107	--	--	0	0	--	--
合计	--	17,499.99	17,499.99	1,394.78	10,863.65	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“半导体封装化学材料技术改造项目”和“半导体封装表面处理设备技术改造项目”由于生产工艺布局的优化与调整,整体进度略有滞后,目前厂房已经完成设备采购安装,处于试生产调试阶段,即将建成投产。“技术中心技术改造项目”由于和公司承担的国家 02 重大科技专项有部分重合,根据 02 专项实施进度做出了相应调整,整体进度略有滞后,目前处于设备调试阶段,即将投入使用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司 2014 年 2 月 20 日召开的第二届董事会第十一次会议决议,同意将超募资金中的人民币 317.00 万元(51 万美元)作为注册资本投入公司和德国 Dr Hesse GmbH & Cie.KG 公司共同投资设立的合资企业上海新阳海斯高科技材料有限公司。截至 2014 年 3 月 31 日止,超募资金专用账户余额为 3498.89 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目	适用										

先期投入及置换情况	公司于 2011 年 8 月 17 日经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具会审字（2011）第 4477 号鉴证报告核准，以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 1,332.05 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 年 3 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金分别存放在浦发银行松江支行、上海银行松江支行、民生银行松江支行的募集资金专项账户，其中部分募集资金以定期存款方式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期土建工程已完工结算，并在各募投项目之间进行分配。 涉及公用工程及配套设施项目款项尚未在各募投项目中进行分配，所以本年度支付公用工程及配套设施项目的款项均通过半导体封装化学材料技术改造项目账户统一支付，待募投项目工程结算完成后，再按照合理方法分摊至各募投项目中。

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

公司募投项目建成投产后，会形成大量新增固定资产，折旧费用将会相应上升，如果营业收入未能实现同步增长，将会导致公司的盈利能力下降。根据目前新市场开发进展情况，公司预计上半年母公司营业收入不会有明显增长，因此上海新阳母公司今年上半年的净利润比去年同期将有较大幅度下降，下降幅度约为40-60%。但与子公司考普乐合并后的营业收入和净利润将仍会有一定幅度的增长。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,674,214.60	218,295,122.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	62,260,022.12	71,071,323.53
应收账款	165,238,046.10	201,413,367.85
预付款项	2,479,035.73	2,369,874.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	366,023.89	1,469,295.68
应收股利		
其他应收款	1,753,002.48	2,306,093.89
买入返售金融资产		
存货	66,978,204.26	46,441,112.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172.62	680,125.15
流动资产合计	478,748,721.80	544,046,316.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	28,700,000.00	15,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	650,000.00	650,000.00

投资性房地产		
固定资产	52,809,675.08	51,579,476.46
在建工程	133,191,870.65	118,864,813.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,242,749.24	78,654,876.19
开发支出	4,117,146.46	4,117,146.46
商誉	133,878,847.88	133,878,847.88
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,203,348.16	5,203,348.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	436,793,637.47	407,948,508.16
资产总计	915,542,359.27	951,994,824.33
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	12,713,040.12	47,802,728.80
应付账款	35,521,263.04	44,542,175.89
预收款项	7,276,299.82	6,440,297.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	938,991.69	3,106,899.36
应交税费	6,208,938.53	9,640,690.60
应付利息	31,111.11	23,333.33
应付股利		
其他应付款	4,451,791.21	4,683,926.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	87,141,435.52	136,240,051.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,163,662.25	20,287,681.31
非流动负债合计	20,163,662.25	20,287,681.31
负债合计	107,305,097.77	156,527,732.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	113,800,000.00	113,800,000.00
资本公积	566,596,033.05	566,404,333.05
减：库存股		
专项储备	5,484,075.79	4,630,103.98
盈余公积	16,822,476.83	16,822,476.83
一般风险准备		
未分配利润	102,529,652.83	93,810,177.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	805,232,238.50	795,467,091.50
少数股东权益	3,005,023.00	
所有者权益（或股东权益）合计	808,237,261.50	795,467,091.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	915,542,359.27	951,994,824.33

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

2、母公司资产负债表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	153,500,008.03	170,177,442.51
交易性金融资产		
应收票据	22,043,199.42	20,289,280.99
应收账款	54,857,194.03	58,772,420.76
预付款项	1,630,598.30	1,875,217.46
应收利息	366,023.89	1,263,435.56
应收股利		
其他应收款	1,456,341.50	1,937,151.23
存货	30,349,101.20	18,037,369.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		599,793.16
流动资产合计	264,202,466.37	272,952,110.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	15,000,000.00	11,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	397,667,025.52	394,497,025.52
投资性房地产		
固定资产	37,384,499.80	35,619,717.99
在建工程	98,801,663.28	95,819,025.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,818,389.30	9,890,939.20
开发支出	4,117,146.46	4,117,146.46
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,239,390.22	1,239,390.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	564,028,114.58	552,183,244.66
资产总计	828,230,580.95	825,135,355.46
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	398,504.00	520,630.00
应付账款	13,083,719.67	14,843,889.06
预收款项	4,763,044.00	2,081,631.00
应付职工薪酬	938,991.69	2,522,799.36
应交税费	1,737,713.54	1,083,244.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	746,103.45	978,101.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	21,668,076.35	22,030,294.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,163,662.25	20,287,681.31
非流动负债合计	20,163,662.25	20,287,681.31
负债合计	41,831,738.60	42,317,976.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	113,800,000.00	113,800,000.00
资本公积	566,469,336.55	566,277,636.55
减：库存股		
专项储备	4,997,648.00	4,479,174.61
盈余公积	16,822,476.83	16,822,476.83
一般风险准备		
未分配利润	84,309,380.97	81,438,091.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	786,398,842.35	782,817,379.39
负债和所有者权益（或股东权益）总	828,230,580.95	825,135,355.46

计		
---	--	--

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

3、合并利润表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	55,000,328.97	30,331,185.45
其中：营业收入	55,000,328.97	30,331,185.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,887,250.86	23,629,309.00
其中：营业成本	30,942,139.40	14,947,686.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	185,183.25	101,066.59
销售费用	4,059,895.05	1,390,838.98
管理费用	11,677,826.91	8,830,767.09
财务费用	-994,216.43	-1,449,336.89
资产减值损失	-983,577.32	-191,713.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	253,005.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,366,083.61	6,701,876.45

加：营业外收入	153,981.06	1,661,936.59
减：营业外支出	56,344.00	9,627.35
其中：非流动资产处置损失	344.00	1,200.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,463,720.67	8,354,185.69
减：所得税费用	1,744,245.48	1,288,498.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,719,475.19	7,065,687.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润	5,833,099.85	75,681.25
归属于母公司所有者的净利润	8,719,475.19	7,065,687.05
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,719,475.19	7,065,687.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,719,475.19	7,065,687.05
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

4、母公司利润表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	26,060,223.91	30,331,185.45
减：营业成本	14,181,715.86	14,962,772.27
营业税金及附加	31,770.92	101,066.59
销售费用	1,792,394.84	1,390,838.98
管理费用	8,371,855.30	8,830,147.55
财务费用	-1,150,132.92	-1,379,936.10
资产减值损失	-239,577.32	-184,813.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	199,153.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,271,350.67	6,611,109.43
加：营业外收入	142,981.06	1,661,936.59
减：营业外支出	36,344.00	9,627.35
其中：非流动资产处置损失	344.00	1,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,377,987.73	8,263,418.67
减：所得税费用	506,698.16	1,288,498.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,871,289.57	6,974,920.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.08
（二）稀释每股收益	0.03	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,871,289.57	6,974,920.03

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

5、合并现金流量表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	73,931,982.38	42,060,003.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,660.96	9,285.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,021,560.84	58,585.58
经营活动现金流入小计	74,960,204.18	42,127,873.84
购买商品、接受劳务支付的现金	49,298,842.99	20,725,562.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,736,647.99	6,156,239.35
支付的各项税费	6,838,779.01	6,532,310.21
支付其他与经营活动有关的现金	5,260,464.30	4,120,985.72
经营活动现金流出小计	73,134,734.29	37,535,097.42
经营活动产生的现金流量净额	1,825,469.89	4,592,776.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,009,538.81	
取得投资收益所收到的现金	253,005.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,555,557.42	1,436,627.40
投资活动现金流入小计	46,841,101.73	1,436,627.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,666,799.12	11,693,802.57
投资支付的现金	15,828,646.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	42,371,354.00	
投资活动现金流出小计	76,866,799.12	11,693,802.57
投资活动产生的现金流量净额	-30,025,697.39	-10,257,175.17

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,005,023.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,005,023.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	317,031.04	289,172.00
筹资活动现金流入小计	3,322,054.04	289,172.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,222.22	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	489,563.27	4,132,714.71
筹资活动现金流出小计	761,785.49	4,132,714.71
筹资活动产生的现金流量净额	2,560,268.55	-3,843,542.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,819.46	26,112.39
五、现金及现金等价物净增加额	-25,638,139.49	-9,481,829.07
加：期初现金及现金等价物余额	196,113,284.06	237,902,006.43
六、期末现金及现金等价物余额	170,475,144.57	228,420,177.36

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

6、母公司现金流量表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,469,572.42	42,060,003.22
收到的税费返还	1,040.96	9,285.04
收到其他与经营活动有关的现金	751,444.81	50,685.58
经营活动现金流入小计	36,222,058.19	42,119,973.84
购买商品、接受劳务支付的现金	24,308,786.11	20,725,562.14
支付给职工以及为职工支付的现金	7,712,645.10	6,156,239.35

支付的各项税费	823,954.25	6,532,310.21
支付其他与经营活动有关的现金	3,782,743.08	4,120,595.72
经营活动现金流出小计	36,628,128.54	37,534,707.42
经营活动产生的现金流量净额	-406,070.35	4,585,266.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	199,153.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,055,241.88	1,366,988.10
投资活动现金流入小计	37,277,395.32	1,366,988.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,933,254.12	11,693,802.57
投资支付的现金	3,128,646.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	39,000,000.00	
投资活动现金流出小计	53,061,900.12	11,693,802.57
投资活动产生的现金流量净额	-15,784,504.80	-10,326,814.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		289,172.00
筹资活动现金流入小计		289,172.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	489,563.27	4,132,714.71
筹资活动现金流出小计	489,563.27	4,132,714.71
筹资活动产生的现金流量净额	-489,563.27	-3,843,542.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,691.39	26,150.90
五、现金及现金等价物净增加额	-16,678,447.03	-9,558,939.86

加：期初现金及现金等价物余额	169,644,141.18	233,216,537.84
六、期末现金及现金等价物余额	152,965,694.15	223,657,597.98

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2014 年 4 月 22 日